证券代码:002436　　证券简称:兴森科技　　公告编号:2023-03-016

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,689,546,322[1] 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

[1] 因公司 2020 年 7 月 23 日发行"兴森转债"可转换公司债券,目前处于转股期,公司股本总数可能发生变动,以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总数为基数。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	兴森科技	股票代码	002436
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋威	陈小曼	
办公地址	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼	深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 8 楼	
传真	0755-26613189	0755-26613189	
电话	0755-26634452	0755-26613445	
电子信箱	stock@chinafastprint.com	stock@chinafastprint.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司确立了"用芯联接数字世界"的全新品牌口号,坚持秉承"助力电子科技持续创新"的使命,为成为全球先进电子电路方案数字制造领军者而不断前行。

公司在 PCB 样板及批量板领域建立起强大的快速制造平台;在 IC 封装基板领域提供快速打样和量产制造服务;在半导体测试板领域打造业内领先的高层数、高厚径比、高平整度、小间距、高可靠性制造工艺能力和快速交付能力;并以印制电路板制造技术为基础,构建开放式技术服务平台,组建业内资深的技术顾问专家团队,形成电子硬件设计领域通用核心技术的综合解决方案能力,结合配套的多品种快速贴装服务能力,为客户提供个性化的一站式服务。

报告期内,公司专注于印制电路板产业,围绕传统 PCB 业务和半导体业务两大主线开展。PCB 业务聚焦于样板快件及批量板的研发、设计、生产、销售和表面贴装,推动客户满意度提升、大客户突破和降本增效;半导体业务聚焦于 IC 封装基板(含 CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板)及半导体测试板,立足于芯片封装和测试环节的关键材料自主配套,一方面加速推动投资扩产的力度和节奏,实现从 CSP 封装基板到 FCBGA 封装基板领域的突破;另一方面加强与行业主流大客户的合作深度和广度。上述产品广泛应用于通信设备、服务器、工业控制及仪器仪表、医疗电子、轨道交通、计算机应用、半导体等多个行业领域。

公司日常生产以客户订单为基础,采用"以销定产"的经营模式,为客户研发、生产提供高效定制化的服务。报告期内公司主要经营模式未发生重大变化。其中:

PCB 业务采用 CAD 设计、制造、SMT 表面贴装和销售的一站式服务经营模式。

半导体业务包含 IC 封装基板和半导体测试板业务。IC 封装基板(含 CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板)采用设计、生产、销售的经营模式,应用领域涵盖存储芯片、应用处理器芯片、射频芯片、传感器芯片、CPU、GPU、FPGA、ASCI 等领域。半导体测试板提供设计、制造、表面贴装和销售的一站式服务经营模式,产品应用于从晶圆测试到封装后测试的各流程中,产品类型包括测试负载板、探针卡、老化板、转接板。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	11,888,295,338.85	8,302,218,319.33	43.19%	6,163,815,892.00
归属于上市公司股东的净资产	6,538,557,557.62	3,762,384,141.26	73.79%	3,289,281,863.27
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	5,353,854,994.29	5,039,987,053.24	6.23%	4,034,655,205.99
归属于上市公司股东的净利润	525,633,105.29	621,490,008.76	−15.42%	521,551,934.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,499,812.73	590,978,178.87	−33.08%	291,899,939.54
经营活动产生的现金流量净额	727,441,912.21	579,717,794.17	25.48%	407,672,002.49
基本每股收益(元/股)	0.33	0.42	−21.43%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.42	−21.43%	0.35
加权平均净资产收益率	10.78%	17.73%	−6.95%	17.29%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,272,476,880.00	1,422,920,142.94	1,456,070,896.35	1,202,387,075.00
归属于上市公司股东的净利润	201,083,305.49	158,348,330.61	158,990,789.26	7,210,679.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,090,773.12	150,129,386.71	128,757,446.10	−4,477,793.20
经营活动产生的现金流量净额	118,784,432.65	92,919,726.65	213,101,501.54	302,636,251.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

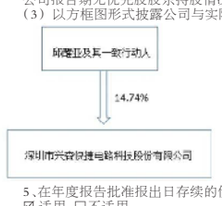
报告期末普通股股东总数	81,564	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,286	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
邱醒亚	境内自然人	14.46%	244,376,552.00	183,282,414.00	质押	95,684,822.00	
曹宁	境内自然人	3.96%	66,902,828.00	0			
叶汉斌	境内自然人	3.74%	63,218,996.00	0			
张丽冰	境内自然人	2.44%	41,150,322.00	5,040,322.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	29,508,288.00	0			
金宇星	境内自然人	1.15%	19,403,813.00	0			
UBS AG	境外法人	1.04%	17,650,786.00	17,439,516.00			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005LCT001 深	其他	1.01%	17,001,745.00	0			
全国社保基金一零七组合	其他	0.92%	15,604,245.00	10,080,645.00			
招商银行股份有限公司-交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金	其他	0.76%	12,829,151.00	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东金宇星先生通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 19,311,452 股,通过普通证券账户持有公司股份 92,361 股,合计持有公司股份 19,403,813 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑ 适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率[2]
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券	兴森转债	128122	2020 年 07 月 23 日	2025 年 07 月 22 日	26,853.41	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称"17 兴森 01",债券代码:112548)每张面值 100 元,发行总额 40,000 万元。"17 兴森 01"于 2022 年 7 月 19 日到期,公司已于 2022 年 7 月 19 日支付 2021 年 7 月 19 日至 2022 年 7 月 18 日期间的利息及本期债券本金并摘牌。2、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司于 2020 年 7 月 23 日向社会公开发行了 268.90 万张可转换公司债券(可转债简称:兴森转债,可转债代码:128122),每张面值 100 元,发行总额 26,890.00 万元。公司已于 2022 年 7 月 25 日(因 2022 年 7 月 23 日为休息日而顺延)向本次付息的债权登记日 2022 年 7 月 22 日(含)前买入并持有本期债券的投资者派发利息,可转债票面利率 0.50%。					

[2] 可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%。

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 14 日出具的《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司及相关债券 2022 年跟踪评级报告》(中鹏信评【2022】跟踪第【243】号 01),公司 2020 年 7 月 23 日公开发行的可转换公司债券的 2022 年跟踪评级结果为:维持本期债券的信用等级为 AA,发行主体信用等级为 AA,维持评级展望为稳定。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	40.87%	48.38%	−7.51%
扣除非经常性损益后净利润	39,549.98	59,097.82	−33.08%
EBITDA 全部债务比	30.10%	34.22%	−4.12%
利息保障倍数	6.00	10.54	−43.07%

三、重要事项

2022 年,供应链重构、俄乌战争等一系列黑天鹅事件,使得国内外政治经济环境面临前所未有的复杂动荡局面。行业层面,全球电子和半导体市场急转直下,整体景气度显著下行、需求低迷、竞争加剧。

报告期内,公司围绕既定的战略方向,全员聚焦、聚力、聚变,在坚守 PCB 产业链的同时,全面聚焦数字化转型,并毫不动摇的坚持高端封装基板业务的战略性投资。公司数字化转型初现成效,高端智能样板工厂在平均 6 天生产周期的基础上,交出了准交率 98%、良率超 97%的答卷,工厂经营效率进一步提升,为公司实现从兴森制造到兴森智造的战略转型奠定了理论和实践基础。下一步公司将在管理层面确立数字化转型的统一思想,以供应链领域"订单 & 计划数字化转型"项目在 PCB 广州事业部、PCB 宜兴事业部、BGA 事业部打造优秀样板为推动数字化转型落脚点。同时,组织分授权、全面预算管理、组织绩效优化、精益六西格玛项目、BCM 业务连续性管理等项目则持续深入推进。在重大项目投资层面,FCBGA 封装基板项目是公司实现技术、产品、客户升级的基础之所在,尽管面临行业景气波动的影响,但整体项目建设按照计划有序推进。珠海 FCBGA 封装基板项目从 2021 年 10 月启动筹建,历时 14 个月完成产线建设并试产成功,2023 年将全力开拓市场、导入量产客户;广州 FCBGA 封装基板项目从 2022 年 4 月 22 日动工,历时 5 个月完成厂房封顶,预计将于 2023 年第四季度完成产线建设,开始试产。

受限于行业层面需求不振、竞争加剧的压力,公司并未实现年初预定的经营目标,整体营收仅实现个位数增长,且净利润受费用拖累有所下滑。报告期内,公司实现营业收入 535,385.50 万元、同比增长 6.23%;归属于上市公司股东的净利润 52,563.31 万元、同比下降 15.42%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,549.98 万元、同比下降 33.08%;总资产 1,188,829.53 万元、较上年末增长 43.19%;归属于上市公司股东的净资产 653,855.76 万元、较上年末增长 73.79%。2022 年,公司整体毛利率下降 3.51 个百分点;期间费用率增加 2.95 个百分点,其中,销售费用率下降 0.02 个百分点,管理费用率增加 1.18 个百分点,研发费用率增加 1.41 个百分点,财务费用率增加 0.38 个百分点。

报告期内,公司各业务板块经营情况如下:

(一)PCB 业务平稳增长,盈利能力有所下滑

报告期内,PCB 行业面临需求不振和竞争加剧的双重压力,增长不达预期。公司 PCB 业务实现收入 403,017.45 万元、同比增长 6.22%,毛利率 30.29%、同比下降 2.84 个百分点。子公司宜兴硅谷在通信和服务器领域的大客户端实现量产突破,全年实现收入 82,403.29 万元、同比增长 22.28%,净利润 2,555.69 万元、同比下降 59.58%,主要系批量板毛利率较低叠加产能利用率不足。Fineline 维持平稳增长,实现收入 151,115.93 万元、同比增长 17.21%,净利润 13,834.50 万元、同比增长 21.72%。英国 Exception 实现收入 6,191.83 万元、同比下降 8.22%,净利润 102.06 万元,同比下降 82.86%,主要系产线升级更新叠加成本上升。

(二)半导体业务持续聚焦 IC 封装基板业务的投资扩产

报告期内,公司半导体业务实现收入 114,897.08 万元、同比增长 6.05%,毛利率 17.25%、同比下降 6.79 个百分点。其中,IC 封装基板业务实现收入 68,954.21 万元、同比增长 3.45%;毛利率 14.75%、同比下降 11.60 个百分点。毛利率下降主要受新增产能拖累以及行业需求大幅下滑导致整体产能利用率下降影响,其中,广州兴科全年亏损 8,292.62 万元。FCBGA 封装基板项目仍处于建设阶段,未产生收入贡献,但整体人工成本、研发投入、试生产损耗等对公司利润形成较大拖累,FCBGA 封装基板项目全年费用投入约 10,200 万元。。

半导体测试板业务实现营收 45,942.87 万元、同比增长 10.21%,毛利率 21.00%、同比提升 0.66 个百分点,主要受益于广州基地半导体测试板工厂新产能贡献,交期和良率指标持续改善。其中,Harbor 实现营收 34,940.93 万元、同比下降 2.94%,净利润 1,328.75 万元、同比下降 65.28%,主要系新产品、新技术研发支出增多叠加成本上升影响。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

法定代表人 :　　:

邱醒亚

二〇二三年三月二十九日

证券代码:002436　　证券简称:兴森科技　　公告编号:2023-03-025

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2022 年年度报告》全文及其摘要,为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况,公司将通过网络远程方式召开公司 2022 年度业绩说明会。

一、说明会召开时间、方式

会议时间:2023 年 4 月 7 日(星期五)15:00～17:00

会议网址:价值在线(www.ir-online.cn)

二、参会人员

公司董事长、总经理邱醒亚先生、独立董事王明强先生、副总经理、董事会秘书蒋威先生、副总经理、财务负责人王凯先生,保荐代表人曾文强先生(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

三、投资者参与方式

投资者可登陆网址(https://eseb.cn/13pX4nQpZJe)或通过微信扫描下方小程序码,参与本次网上业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议,公司提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:访问活动页面网址 https://eseb.cn/13pX4nQpZJe;

参与方式二:通过微信扫一扫下方小程序码:

投资者可于 2023 年 4 月 7 日前点击"进入会议"进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码:002436　　证券简称:兴森科技　　公告编号:2023-03-017

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,具体情况如下:

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更原因

2022 年 11 月 30 日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会【2022】31 号,以下简称"准则解释第 16 号"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容。其中第一项"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

2、本次会计政策变更时间

(1)准则解释第 16 号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

(2)准则解释第 16 号中"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。

3、变更前后公司采用的会计政策

(1)变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(2)变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将执行准则解释第 16 号。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行"准则解释第 16 号"的会计政策变更是根据财政部相关会计准则及衔接规定进行的相应变更,本次变更后能更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和实际情况。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、董事会审议本次会计政策变更的说明

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求实施的,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

四、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司依照财政部相关规定,对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。该议案审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。

我们一致同意公司会计政策变更事项。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整,符合财政部的相关规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码:002436　　证券简称:兴森科技　　公告编号:2023-03-022

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品,具体情况如下:

一、使用闲置自有资金购买理财产品情况

1、投资目的

在确保正常经营和资金安全的情况下,提高闲置自有资金使用效率,合理利用闲置自有资金,获取投资收益。

2、投资额度

不超过人民币 60,000 万元购买理财产品,上述额度在有效期内可循环使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

3、投资品种

安全性高、流动性好的低风险、短期(一般不超过一年)的投资产品,不涉及高风险投资。

4、资金来源

闲置自有资金。

5、投资期限

自本次董事会审议通过之日起一年。

6、受托方

产品发行主体应当为商业银行等金融机构或类金融机构,与公司不存在关联关系。

7、实施方式

授权公司董事长在额度范围内负责办理具体事项及签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同等相关文件。公司财务部负责组织实施。

二、审议程序

2023 年 3 月 29 日,公司第六届董事会第二十次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。同日,公司召开的第六届监事会第十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了前述议案。

本次投资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司拟投资的理财产品属于短期、低风险的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。

2、风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择短期、低风险的投资品种;

(2)公司财务部门建立台账对所购买的理财产品进行管理,相关人员及时分析和跟踪投资进展,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查、核实;

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查;

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。使用闲置自有资金购买低风险理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司及子公司在确保正常经营和资金安全的情况下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险的理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,获取投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效。

独立董事一致同意公司使用不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金购买理财产品事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用额度不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金购买理财产品,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。监事会一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

七、中介机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表明确同意意见,履行了必要的审批和决策程序。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。综上所述,保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。

八、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

3、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十五次会议决议;

4、民生证券股份有限公司出具的《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十日

证券代码:002436　　证券简称:兴森科技　　公告编号:2023-03-023

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投资项目的概述

(一)募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3305 号)核准,深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴森科技")向 18 名特定对象非公开发行人民币普通股 201,612,903 股,本次非公开发行新增股份已于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为人民币 1,999,999,997.76 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 21,508,363.08 元后,实际募集资金净额为人民币 1,978,491,634.68 元。上述募集资金总额 1,999,999,997.76 扣除保荐承销费 18,867,924.51 元后余额 1,981,132,073.25 元已汇入公司设立的非公开发行募集资金专户中,业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(众验字【2022】第 07282 号)。

截至 2022 年 12 月 31 日,本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用情况如下:

单位:万元

序号	项目	实施主体	拟投入募集资金	累计投入募投项目金额	项目剩余可使用募集资金金额 1
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	宜兴硅谷	145,000.00	21,853.05	121,427.30
2	广州兴森集成电路封装基板项目	广州科技	15,000.00	8,849.92	6,206.31
3	补充流动资金及偿还银行贷款	兴森科技	40,000.00	40,000.00	27.87
合计			200,000.00	70,702.97	127,661.48

注 1:该列金额含利息。

(二)拟变更募集资金用途的原因及基本情况

公司募投项目"宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目"(以下简称"原募投项目")主要生产单双面板、多层板,投产后将新增 8 万平方米/月的印刷线路板产能。鉴于目前 PCB 行业面临需求不振、竞争加剧、增长不达预期的现状,公司经审慎研究,认为如按原规划实施可能存在产能消化风险、成本代价逐步增加、未能达到预期效益等不利情形。为提高募集资金使用效率、保障主营业务长远发展以维护全体股东利益,公司拟放缓原募投项目投资节奏,并将尚未投入的 35,000 万元募集资金用于全资子公司广州兴森投资有限公司(以下简称"兴森投资")收购揖斐电电子(北京)有限公司(以下简称"北京揖斐电")100%股权项目。本次拟变更用途的募集资金占募集资金净额的 17.69%。调整前后募集资金用途如下:

单位:万元

序号	实施主体	募集资金用途	调整前		调整后	
			项目总投资金额	拟投入募集资金	项目总投资金额	拟投入募集资金
1	宜兴硅谷	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目	157,966.52	145,000.00	157,966.52	110,000.00
2	广州科技	广州兴森集成电路封装基板项目	36,227.40	15,000.00	36,227.40	15,000.00
3	兴森科技	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
4	兴森投资	收购北京揖斐电 100%股权	–	–	87,000.00	35,000.00
合计		–	234,193.96	200,000.00	321,193.96	200,000.00

(三)已履行及尚需履行的审议程序

2023 年 3 月 29 日,公司召开第六届董事会第二十次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》,独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本次变更部分募集资金用途及使用募集资金收购事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

本次事项尚需提交公司股东大会审议;如股东大会未通过本议案,公司将继续推进使用自筹资金收购北京揖斐电,募集资金将继续用于原募投项目的建设。

二、新募投项目情况说明

(一)项目概述

兴森投资拟以 176.61 亿日元(税前,按 20.3 日元 =1 元人民币的汇率计算为 8.7 亿元人民币,定价基准日为 2022 年 6 月 30 日)作为基础购买价格(将就净资产变动额等调整项对基础购买价格进行调整)收购揖斐电株式会社持有的北京揖斐电 100%股权(以下简称"新募投项目")。

(二)交易对方的基本情况

1、企业名称:IBIDEN CO.,LTD.

日文原名:イビデン株式会社

中文名称:揖斐电株式会社

2、注册地址:岐阜县大垣市神田町 2-1

3、公司类型:上市公司

4、法定代表人:青木武志

5、成立时间:1912 年 11 月 25 日

6、注册资本:64,152 百万日元

7、主营业务:从事电子产品、陶瓷产品及其他电子产品的生产和销售。

8、股权关系:截至 2022 年 9 月 30 日,日本总信托银行株式会社(信托口径)持有揖斐电 2,061.6 万股,占揖斐电总股本的 14.74%,为第一大股东。

9、经在中国执行信息公开网查询,揖斐电非失信被执行人。

(三)交易标的基本情况

1、企业名称:揖斐电电子(北京)有限公司

2、统一社会信用代码:91110302801148435G

3、注册地址:北京市北京经济技术开发区荣昌东街 15 号

4、法定代表人:宫崎信治

5、成立时间:2000 年 12 月 25 日

6、注册资本:10,000 万美元

7、类型:有限责任公司(外国法人独资)

8、经营范围:生产、加工高密度印刷线路板、印刷线路板设备的零部件、印刷线路板材料;开发、设计高密度印刷线路板、印刷线路板设备的零部件、印刷线路板材料;销售自产产品;对外提供印刷线路板的分析、解析、测试、最终检测服务;提供自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术服务;批发、进出口高密度印刷线路板、印刷线路板设备的零部件、印刷线路板各类材料。

9、产权及控制关系:本次交易前,揖斐电株式会社持有北京揖斐电 100%股权,北京揖斐电为揖斐电株式会社全资子公司。

10、最近一年一期主要财务数据:

单位:人民币万元

主要财务指标	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	139,102	144,742
负债总额	18,939	19,332
净资产	120,163	125,410
资产负债率	13.62%	13.36%
主要财务指标	2021 年度(经审计)	2022 年 1-9 月(未经审计)
营业收入	87,936	67,206
利润总额	−5,355	5,314
净利润	−5,464	5,247

11、经在中国执行信息公开网查询,北京揖斐电非失信被执行人。

12、标的公司股权清晰,不存在出资不实或者影响其合法存续的情况,亦不存在重大争议、仲裁或诉讼事项;交易对方合法拥有标的公司的完整权利,不存在抵押、质押等权利限制以及因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东权利行使之情形。

三、新募投项目可行性分析

1、把握行业技术升级带来的增量市场

根据 Prismark 报告,2022 年度全球 HDI 板行业整体规模达 117.63 亿美元,预计 2027 年 HDI 板的市场规模将达到 145.81 亿美元,2022-2027 年的复合增长率为 4.40%。

标的公司北京揖斐电专注于面向移动通讯用印制电路板产品,以高性能微小导孔和微细线路的高密度互连电路板(普通 HDI 和 Anylayer HDI)、mSAP 流程的类载板(SLP)和模组类封装基板产品为主要产品,其产品所在细分市场前景广阔,且随着 5G 手机渗透率的提升,SiP 工艺从单面 SMT、双面 SMT 发展至 3D 堆叠技术,对基板制程技术能力的要求显著提高,同时,5G 智能手机需要支持的频段远超过 4G 智能手机,需要集成在射频前端模组中的滤波器、开关、天线和功放芯片数量大幅增加,单只 5G 智能手机中模组的数量和模组封装体的尺寸都超过 4G 智能手机,意味着模组基板的出货数量和价值量将会随着 5G 智能手机渗透率的提升而持续增长。收购完成后,公司将具备 mSAP 流程的类载板(SLP)和模组类封装基板产品量产能力,能把握行业技术升级带来的增量市场,形成新的利润增长点。

2、布局高端 HDI 板、类载板,打造 PCB 全产品生产线

兴森科技是国内知名的印制电路板样板快件、小批量板的设计及制造服务商,在 PCB 高多层板、刚挠板、封装基板等细分领域布局较广。标的公司在 HDI 领域深耕多年,技术处于行业领先水平,通过其任意叠孔互联技术,产品覆盖一阶、两阶、三阶、四阶 HDI(FVSS-1),以及任意互联 HDI(FVSS-3),是国内外各主要手机厂商的核心供应商。收购完成后,公司可快速切入高端 HDI、类载板领域,将实现高多层 PCB、Anylayer HDI、类载板、CSP 封装基板和 FCBGA 封装基板的全领域产品布局,提升综合竞争力。

3、发挥协同效应,提升公司盈利水平

(1)业务及客户的协同效应

兴森科技在 PCB 高多层板、刚挠板、封装基板等细分领域布局较广,并已实现集成电路封装基板 FCBOC、FCCSP、Coreless 和 ETS 等产品的稳定量产,与国内外主流存储芯片、应用处理器芯片、射频芯片、传感器芯片客户建立起稳定的合作关系。同时,公司在 FCBGA 封装基板领域大力投资扩产,以配套国内 CPU、GPU、FPGA、ASIC 等超大规模集成电路的国产化芯片封装配套需求,解决目前国内在该细分领域被"卡脖子"的现状,并力争成为该细分领域全球核心供应商。标的公司专注于移动通讯领域 HDI 板,并在智能手机领域积累了一批优质客户资源。

收购完成后,双方可在产品、客户、供应链层面实现深度对接,除公司原有通信、工控、医疗、安防、半导体等行业客户外,将助